

# 第 122 回マイクロ接合研究委員会 プログラム

日 時：平成 30年 7月 27日(金) 10:30～16:55

場 所：(株)島津製作所 関西支社 マルチホール(大阪 梅田)

	時 間	題 目	講 演 者	
	司 会 中島 泰 (三菱電機)			
平成 30 年 7 月 27 日  (金)	10:30～11:15	Mate2018 受賞講演 『過渡熱解析による3次元積層 IC 内の アンダーフィル層の熱抵抗の評価』 (資料番号MJ-743-2018)	富士通(株) ○佐々木 真 菊池 遼, 酒井 泰治, 作山 誠樹	
	11:15～12:00	『Sn-Ag 系薄膜接合による 3D-IC 低温低加圧実装プロセスに関する研究』 (資料番号MJ-744-2018)	大阪大学 ○岩田 剛治 重本 拓巳, 成田 尚希, 米田 聖人 山本 宗裕, 佐藤 了平	
	12:00～13:15	昼 食 休 憩		
	13:15～13:35	委 員 会 議 事 MJ賞 表賞式		
		司 会 柴柳 敏哉 (富山大学)		
	13:35～14:20	『ギ酸を用いた鉛フリーはんだ付けプロセス』 (資料番号MJ-745-2018)	オリジン電気(株) ○小澤 直人 大久保達生, 松田 純, 酒井 達郎	
	14:20～15:05	『A5052 アルミニウム合金－熱可塑性プラスチック異材接合』 (資料番号MJ-746-2018)	広島工業大学 ○日野 実 (株)サーテック永田 永田 教人 富山県立大学 永田 員也	
	15:05～15:25	休 憩		
		司 会 富田 正吾 (富山県工業技術センター)		
	15:25～16:10	『半導体レーザを使用したマイクロ接合 ならびに金型表面の微細肉盛溶接』 (資料番号MJ-747-2018)	石川県工業試験場 ○舟田 義則	
16:10～16:55	『島津製作所 XPS 分析装置の最新技術紹介』 (資料番号MJ-748-2018)	(株)島津製作所 ○渡邊 俊祐		

※プログラムは都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。